

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2017-032

惠州中京电子科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2017 年 3 月 31 日公司总股本 377,780,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中京电子	股票代码	002579
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	余祥斌	黄若蕾	
办公地址	广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号	广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号	
电话	0752-2057992	0752-2057992	
电子信箱	obd@ceepcb.com	huangruolei@ceepcb.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司目前主营业务为印制线路板（PCB，含HDI）的研发、生产和销售。PCB为电子工业之母，公司PCB产品广泛应用于消费电子、网络通讯、汽车电子、医疗器械、金融终端、智能可穿戴设备等高新技术产品领域，产品远销欧美、日本、台湾等国内外市场。

公司多年专注于PCB产品的研发及生产，在PCB领域已积累了丰富的实践经验，并建立了完善的研发、技术、生产、销售、品质及内控管理体系。公司是CPCA行业协会副理事长单位，行业标准的制定单位之一，连续多年入围“中国印制电路行业百强企业”，拥有省级工程研发中心和企业技术中心，拥有国家级博士后科研工作站，是广东省创新型企业，在行业内处于先进地位。公司紧跟市场变化，持续调整优化产业结构，积极布局高端PCB市场，目前产品重点定位于中高端多层、高密度互联（HDI）印制线路板。公司募投项目HDI产品目前已经实现大批量生产，其产品结构持续优化、产能稳步提升、产品品质逐渐改善，该类产品将广泛应用于高清晰LED显示、4G/5G类通讯终端、虚拟及增强现实终端、可穿戴智能终端等新兴应用领域，将为公司PCB产品整体盈利能力提升作出贡献。

在稳健发展PCB产业的同时，公司根据自身发展特点、国家政策导向、市场中行业发展趋势与需求，积极探索公司在新经济、新产业的布局与发展，确立了在医疗健康领域开拓新业务的战略发展方向，并全资设立相关医疗子公司开展相关业务，引进并储备相关人才，积极进行市场调研并探索实施并购重组等外延式发展路径。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	794,188,458.63	578,592,369.01	37.26%	482,698,640.39
归属于上市公司股东的净利润	110,986,387.78	29,239,963.34	279.57%	19,358,473.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,393,436.34	12,935,665.33	42.19%	17,784,451.08
经营活动产生的现金流量净额	-3,906,355.17	85,533,476.98	-104.57%	11,698,682.03
基本每股收益（元/股）	0.31	0.08	287.50%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.08	287.50%	0.05
加权平均净资产收益率	15.04%	4.57%	10.47%	3.15%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末

资产总额	1,566,287,988.44	1,261,261,620.02	24.18%	1,055,983,924.46
归属于上市公司股东的净资产	971,928,664.65	650,277,495.85	49.46%	628,050,906.02

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	160,589,327.86	185,653,839.93	199,562,986.80	248,382,304.04
归属于上市公司股东的净利润	88,511,277.58	3,093,265.74	4,607,039.61	14,774,804.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,431,365.67	-500,312.13	4,374,655.52	13,087,727.28
经营活动产生的现金流量净额	-191,064.67	-15,045,441.06	-6,915,704.75	18,245,855.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,091	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,338	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
惠州市京港投资发展有限公司	境内非国有法人	30.24%	111,858,462	0	质押	67,600,000	
香港中扬电子科技有限公司	境外法人	19.32%	71,492,613	0			
杨林	境内自然人	5.27%	19,490,000	19,490,000			
惠州市普惠投资有限公司	境内非国有法人	0.66%	2,448,310	0			
林道治	境内自然人	0.54%	2,000,000	0			
李爱儿	境内自然人	0.50%	1,833,300	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.45%	1,647,200	0			
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.38%	1,403,200	0			
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	其他	0.35%	1,300,000	0			
龚梅贞		0.34%	1,259,533	0			
上述股东关联关系或一致行动	公司前 10 名股东中，杨林为惠州市京港投资发展有限公司控股股东。公司未知其他股东						

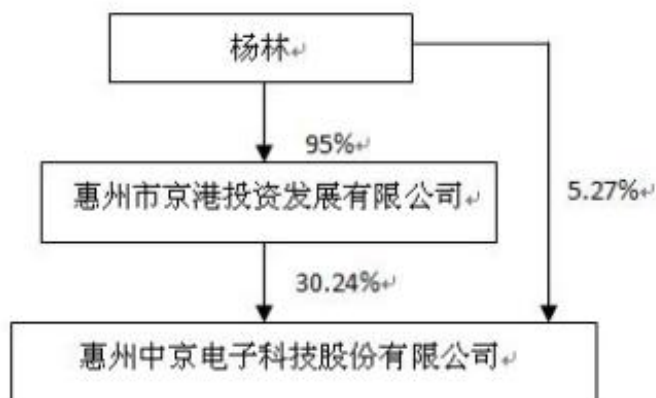
的说明	之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年公司稳健发展PCB主业的同时，对医疗健康战略业务进行了积极探索并开展了相关工作。一方面，公司继续深耕主业，重点围绕HDI新产品的产能及技术品质提升开展了大量工作，通过优化产品结构，提升技术研发水平、优化内部管理机制、加强市场管理及客户服务质量等措施，较大幅度提高了主营产品产销规模，进一步强化了公司在PCB领域的持续竞争力。另一方面，公司积极布局向医疗健康领域拓展新业务，设立全资医疗子公司开展相关业务，引进并储备相关人才，做了大量项目考察与产业分析工作，并开始通过并购重组方式与优质医疗服务机构开展合作。

报告期内公司实现营业收入79,418.85万元，比上年同期增长37.26%；实现利润总额14,526.25万元，比上年同期增长335.10%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）11,098.64万元，比上年同期增长279.57%。

报告期内重点完成工作如下：

1、非公开发行股份

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1298号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象（公司实际控制人杨林先生）非公开发行人民币普通股（A股）股票1,949万股，发行价为每股人民币11.64元，共计募集资金22,686.36万元，扣除相关发行费用后，公司本次募集资金净额为22,053.72万元。本次非公开发行的股份于2016年11月21日在深交所上市。本次定向增发募集资金进一步优化了公司长期财务结构，提高了公司盈利能力，为公司未来转型发展提供了经营资金支持。

2、PCB产业能力提升

公司继续挖掘PCB产业发展潜力，重点提升HDI产品的盈利能力。报告期内，HDI产品工艺技术取得突破发展，公司开始小批量生产二阶、三阶HDI产品，并已经具备部分Any-layer HDI的量产能力。如批量生产最小线宽线距达到2Mil/2Mil，10层2阶HDI最小成品完成厚度可做到0.65MM，公司在控深盲孔、非平面台阶型特殊HDI产品技术已经处于行业领先水平，产品广泛应用于小点间距高清LED显示屏、4G移动通讯终端等新技术领域。

公司HDI新产品在高清LED显示屏、智能4G/5G手机与通讯、汽车电子、智能可穿戴终端、医疗电子终端、AR/VR、人工智能等新兴应用领域拥有广阔市场发展前景，公司也将不断在上述新领域开拓优质客户，建立了与闻泰通讯、华勤通讯、锐嘉科、联建光电、Honeywell、歌尔声学、AB电子等国内外知名企业的长期合作关系。

3、经营管理优化

报告期内，公司进一步深化了内部考核、激励机制与管理架构变革，形成集团控股战略框架基础上，进一步完善各职能部门配置及内部控制规范，完善了下属子公司运营管理及汇报机制。

在团队管理方面，公司进一步完善实施以净利润（结合EVA指标）导向作为主要考核目标的绩效考核与分配体系，确保责任明确，激励清晰，奖罚分明，有效推进团队管理优化。公司启动实施股权激励计划，向董事、中高级管理人员、核心技术（业务）人员等授予限制性股票，并于2017年3月完成公司限制性股票激励计划首次登记授予。股权激励的实施，有力

激发团队的积极性和创造性，同时进一步提高公司对优秀人才的吸引力。

在生产管理方面，公司持续推行精益生产。利用ERP系统工具提升数字化管理，提高数据的准确性、时效性；强化标准化作业、员工技能及质量意识培训，提升产品质量；建立了细化至生产工序的物耗、人工、能耗标准考核体系，进一步加强了生产成本管控。加强清洁生产管理，节能增效，实现可持续发展。

4、技术研究开发

报告期内，为促进公司高端高密度线路板的发展，公司研发投入约2600万元，占公司全年营业收入的3.27%。报告期内开展了“智能可穿戴终端用高密度印制电路板关键技术研究”、“智能车载电子印制电路组件关键技术研究”、“Any-layer HDI印制电路板关键性技术研究”、“LED拼接屏印制电路板制作工艺技术研究”、“高阶HDI板叠孔制造工艺的研究”、“印制电路板激光直接成像曝光技术的研究”、“HDI板新型盲孔填孔技术研究”、“印制电路板OSP表面处理技术研究”、“印制电路板密集孔钻孔工艺技术研究”等多个项目的研发工作。

报告期内，公司获得授权专利13项，发表技术论文9篇，高级工程师获评1人。上述成果的取得，进一步增强了公司的核心竞争力、巩固了行业内技术领先优势，为实施公司中长期计划和达成中期经营计划目标提供了足够的工艺与技术保障。

5、战略转型发展

经过充分的市场与产业调研、经营项目考察及运营方式探索等准备工作，公司已逐步开展在医疗健康领域的战略转型布局，并设立全资子公司中京医疗，初步完成管理架构和管理团队的搭建。公司于2016年12月筹划重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购广州复大医疗股份有限公司100%股权，这是公司切入医疗服务核心领域的重要举措，目前该重组事项正在进行中。公司将在医疗健康领域开展陆续投资，立志长期进行深耕细作。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
双面板	182,317,828.74	166,969,688.38	8.42%	2.29%	2.20%	0.08%

多层板	599,005,916.80	488,872,224.45	18.39%	55.34%	53.15%	1.17%
-----	----------------	----------------	--------	--------	--------	-------

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

2016年1月27日公司将持有的广东乐源数字技术有限公司20.45%的股权转让给乐六平，本次交易产生资产处置净收益约人民币8733.01万元，导致报告期归属上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期有较大增长。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内公司合并的报表范围增加合并单位一家，公司新设成立子公司惠州中京医疗控股有限公司，注册资本人民币5000万元，公司持股比例100%。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

惠州中京电子科技股份有限公司

2017 年 4 月 13 日